	芯丰集成	电路封装压焊	图 图·	号:314	BD011	1 版	本	A. 0
贴片方向(芯片与片耳	†	E架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔/	MICH S	殊要求(Remarka 5片最高点的线弧				
	0.4	13	,					
	99.0 <u>▼GND14</u> VDD 1				7			
			请仔细核对焊 请签字回传,	i thi thi		212 12	如无证	
O /	点胶方式 点胶 画形	射紫外线, 如不能请讲明 蓝朋	请签字回传,	谢谢!	客户回签	选择。 数	-	
Product Type)	点胶 画形	产品是否可以服 射紫外线。 如不能请讲明	请签字回传,	谢谢! 芯片滅薄厚	客户回签	212 12	77	
PF品型号 (Product Type) 芯片名称	点胶 画形	产品是否可以服 射紫外线。 如不能请讲明	请签字回传,风险监控:	谢谢!	客户回签 lcknoss	5: 模稱	10um	>n↓k
PF品型号 (Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸	点胶 画形 • / HS26P10	产品是否可以照 射繁外线, 如不能请讲明	请签字回传, 风险监控: 低风险 银合金线0.8mil	谢谢! 芯片减薄厚 Chip thinning thi 装片胶	客户回签 lcknoss	注: 模稱 300±1	10um	>n↓k
章頭针 多頭針 ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ /	・ / HS26P10 HS5085 1. 195X0. 755mm S0P14 (8. 65X3. 9X1.	产品是否可以照 射繁外线。 如不能请讲明	请签字回传, 风险监控: 低风险 银合金线0.8mil 60X60um	谢谢! 芯片减薄厚Chip thinning th 装片胶Epoxy (二选一) 塑封料	客户回签 度 ckness 首选 g	き: 校 稿 300±1 9246LB5(4	10um 导电服	文の 集
Pight 多項針 Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸 (Die Size) 封装形式 (Package Type) 引 线 框	点股 画版 / HS26P10 HS5085 1. 195X0. 755mm	产品是否可以照 射繁外线。 如不能请讲明	请签字回传, 风险监控: 低风险 银合金线0.8mil 60X60um 86um	游谢! 芯片減薄厚 Chip thinning th 装片胶 Epoxy (二选一) 塑封料 Molding Compound	客户回签 度(ckness 首选 9 备选	300±1 9246LB5(4 / EMC-GR710	10um 导电胆 0F GN	>の以 (交)
単項针 多項針 ・ / 产品型号 (Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸 (Die Size) 封装形式 (Package Type)	・	产品是否可以照 射紫外线。 如不能请讲明 遊郎 线 材 直 径 (Wire Diameter) 压焊点尺寸 (Pad Opening) 最小压焊向距 (Min Pitch) 4 先 程 线 (Wire Bond Start) 焊 线 总 数 (Quantity of Wire) 最长线长/总线长	请签字回传, 风险监控: 低风险 银合金线0.8mil 60X60um 86um PIN14	谢谢! 芯片減薄厚 Chip thinning th 装片胶 Epoxy (二选一) 塑封料 Molding Compound (二选一)	客户回签 度 (cknoss 首选 9 备选 首选 E	300±1 9246LB5(4 / EMC-GR710	IOum 导电用 OF GN 2-SP1	ンの状 (交)
単項针 多項針 ・ / 产品型号 (Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸 (Die Size) 封装形式 (Package Type) 引 线 框 (Lead Frame) L/F eし渡方式 L/F Plating Type)	A股 画形 / HS26P10 HS5085 1. 195X0. 755mm SOP14 (8. 65X3. 9X1. e=1. 27) SOP14L (80X80) -12F 雾 锡	产品是否可以照 射繁外线。 如不能请讲明 线 材 直 径 (Wire Diameter) 压焊点尺寸 (Pad Opening) 最小压焊间距 (Min Pitch) 4 先 焊 线 (Wire Bond Start) 焊 线 总 数 (Quantity of Wire) 最长线长/总线长 (Length of Wire)	请签字回传, 风险监控: 低风险 银合金线0.8mil 60X60um 86um PIN14	游谢! 芯片減薄厚 Chip thinning th 装片胶 Epoxy (二选一) 塑封料 Molding Compound	客户回签 度 (cknoss 首选 9 备选 首选 E	300±1 9246LB5(4 / EMC-GR710	IOum 导电用 OF GN 2-SP1	>の以 (交)
単項针 多項針 Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸 (Die Size) 封装形式 (Package Type) 引线框 (Lead Frame) L/F 电镀方式 L/F Plating Type) 晶圏尺寸/切割方式 ifer Size/Cutting Mode)	AR 画版 画版	产品是否可以照 射繁外线。 如不能请讲明 线 材 直 径 (Wire Diameter) 压焊点尺寸 (Pad Opening) 最小压焊间距 (Min Pitch) 4 先 焊 线 (Wire Bond Start) 焊 线 总 数 (Quantity of Wire) 最长线长/总线长 (Length of Wire)	请签字回传,	谢谢! 芯片減薄厚 Chip thinning th 装片胶 Epoxy (二选一) 塑封料 Molding Compound (二选一)	客户回签 度ickness 首选 g 备选 首选 E	300±1 9246LB5(4 / EMC-GR710	IOum 导电用 OF GN 2-SP1	ンの状 (交)
単原针 多原针 Product Type) 芯片名称 (Die Name) 芯片尺寸 (Die Size) 封装形式 (Package Type) 引线框 (Lead Frame) L/F电镀方式 (L/F Plating Type) 出版尺寸(切割方式 afer Size/Cutting Mode)	AR 画版 画版	产品是否可以照 射繁外线。 如不能请讲明	请签字回传,	谢谢! 芯片减薄厚 Chip thinning th 装片胶 Epoxy (二选一) 塑封料 Molding Compound (二选一) CUP/BG	客户回签 度(ckness) 首选 9 备选 首选 E	300±1 9246LB5(4 / EMC-GR710 EMG-600-3	10um 导电服 2-SP1	ンの水 (交) NO